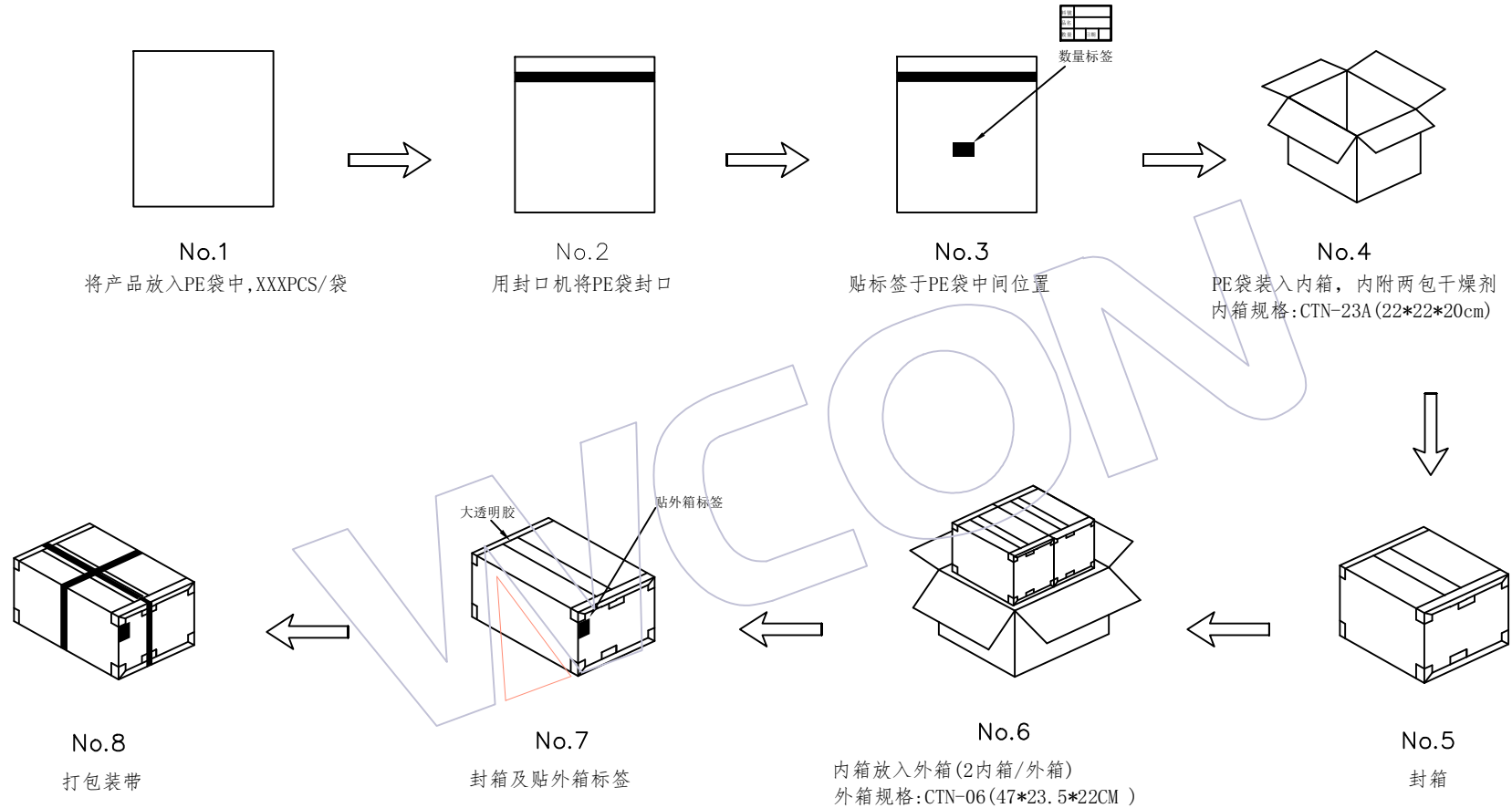


HSF



说明

1. 注意各标签样式、位置及方向的一致性;
2. 标签如客户有特殊要求,则按客户要求黏贴;
3. 打外箱包装带时需注意,打为十字型,另出国内客户,未打包装带。
4. 未尽事宜依据交货注意事项。

变更 记录						零件图		颜色 COLOR	———		SCALE	1:1	WCON		
						X.		材质 MATERIAL	———		UNIT	mm			
						X.X	±0.10	设计 DESING	苏 珊	2023/03/16	SIZE	A4	WCON ELECTRONICS (GUAMGDONG) CO.LTD		
						X.XX	±0.05								
						X.XXX	±0.02								
	A0	2023/03/16	NEW		———	———	Angle		审 核 CHECK			SHEET	1/1	料 号 PART NO.	WF4141-2WSXXW02
	版次 REV	日期 DATE	变 更 说 明 MODIFICATION DESCRIPTION		变更 CHANGE	核 准 APPROVE	X.	± 2°	核 准 APPROVE			PROJ.		品 名 TITLE:	4. 14mm Wafer, Housing, Double Row Vertical DIP, XFP, 袋装规范
							DIM	TOL							